

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年4月30日)

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	参与公司2023年度及2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的投资者	
会议时间	2024年4月30日 8:30-9:30	
会议地点	进门财经APP/进门财经小程序 (https://s.comein.cn/A9BVQ)	
上市公司接待人员姓名	董事长 孙成思 总经理 何瀚 董事会秘书 黄炎烽 独立董事 方吉槟	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年4月30日，公司在进门财经平台召开了2023年度及2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司高管对报告期内业绩情况进行了总结与分析，并与参会的投资者进行了互动交流，交流内容如下：</p> <p>Q1. 公司产品主要应用在哪些领域？其中哪些应用领域今年增速比较高？ A1: 从终端应用需求来看，公司产品主要应用于PC、手机、智能穿戴、工控、服务器等领域。随着存储市场的回暖复苏，这些应用领域的需求在今年都有所增长，其中手机的增速最高，主要是受手机市场复苏及单机容量提升的影响。</p> <p>Q2. 如何看待今年的存储行业周期变化？公司今年的存货策略又是怎样的？ A2: 2024年伴随终端需求复苏，上游减产涨价策略延续，终端客户库存不断改善，逐渐走向供需平衡的复苏，存储器价格在今年一季度仍旧持续增长，二季度有望继续上行，下半年的行业走势有待观察。2024年一季度公司采取较为中性的备货策略，按需采购，一季度末存货金额与2023年末基本持平，预计二季度将继续保持按需采购的备货策略。</p> <p>Q3. 如何展望公司未来在AI相关的业务布局，是否有客户导入等新的进展？ A3: 公司与OPPO、传音等主要的AI手机厂商和HP、联想、Acer等主要的AIPC厂商建立了密切的合作关系，新产品在不断导入。公司面向AI手机已推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品；面向AIPC已推出DDR5、PCIe 4.0等高性能存储产品；面向AI服务器，已推出企业级SATA SSD、企业级PCIe SSD、RDIMM和CXL内存等产品。公司始终保持敏锐洞察力，面对</p>	

AI 端侧设备本地化部署和轻量化模型的发展趋势，积极探索存储创新应用，赋能新兴终端应用的规模化落地。

Q4. 如何评估二季度及下半年原厂控产及涨价意愿？存储市场是否会持续高景气度？

A4：随着原厂逐步复产，二季度继续涨价的意愿很强，三季度和四季度的行业趋势有待观察。但目前还是看到不少的积极因素，比如 HBM 需求爆满、北美服务器市场复苏强劲、国内消费电子市场也在逐步复苏。今年下半年存储市场是否景气，关键看 AI 手机和 AIPC 新品能不能带动大的换机潮和国内服务器市场能否逐步复苏。从中长期来看，中高端存储的景气度是确定的，因为 HBM 和 AI 终端新应用的拉动作用，原厂的重心将放在高价值增量应用上，以追求更高的商业价值和财务回报，不愿意在相对传统的领域做低价竞争，价格预计不会出现剧烈恶化的情况。

Q5. 从中长期看，驱动公司利润增长有哪些因素？

A5：整个存储市场规模巨大，国内半导体存储器厂商拥有较好的发展机遇。因此，当前驱动公司利润的核心要素是营收规模的快速提升。另一方面，公司在利基型存储市场（智能穿戴和工车规）利润相对较高，而且比较稳定，在这些市场市占率的提升和市场空间的成长也是提升公司利润水平的关键因素。最后，公司在主控和先进封测方面的布局能够提升公司在产业链的价值占比，进而提升利润水平。

Q6. 介绍下晶圆级封测项目的最新进展、封装技术类型以及预计实现的产能情况？

A6：公司晶圆级先进封测项目是大湾区重点产业项目，旨在打造全球领先的半导体先进封测标杆性企业。该项目专注于高性能计算、先进智能终端、物联网等领域的高端封装需求，涵盖 WLCSP、2.5D/3D、HBM 等晶圆级先进封装技术。目前，该项目已经进入实施阶段，正在进行设备采购和厂房建设准备工作。该项目第一阶段满产后预计月产能为 2 万片 12 寸晶圆，后续将根据情况进行扩产。

Q7. 请详细解读下公司的中长期发展战略？

A7：公司从全局出发，以前瞻性的战略思维和严谨的市场洞察为基础，制定了一套能够有效驱动公司稳健发展的中长期战略——“5+2+X”战略。“5”代表了公司聚焦五大应用市场（手机、PC、服务器、智能穿戴和工车规），其中在手机、PC、服务器等三大主要细分市场着力提升市场份额与核心竞争力，力争实现与更多一线客户的深度合作；在智能穿戴和工车规市场投入战略性资源，力争成为主要参与者；“2”代表了公司二次增长曲线的两个关键布局：芯片设计和晶圆级先进封测，芯片设计将为公司打造服务 AI 时代高性能存储器奠定坚实的技术基础，晶圆级先进封测将构建 HBM 和 Chiplet 实现的封装技术基础，确保公司在 AI 和后摩尔时代的行业竞争力。“X”代表了公司对存算一体、新接口、新介质和先进测试设备等创新领域的探索与开拓。通过以上战略布局，兼顾公司短/中/长期发展目标，服务产业和国家战略方向，提升公司的价值和股

	<p>东回报。</p> <p>Q8. 公司在手机领域目前已进入哪些客户？哪些存储产品可适用于手机？ A8: 得益于公司在手机领域持续不断进行技术投入和产业积累，目前逐步得到了一线客户的认可，产品已进入OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL等知名客户。公司嵌入式存储产品中的eMMC5.1、UFS2.2/UFS3.1、eMCP、uMCP、LPDDR4X/5X可适用于智能手机。</p> <p>Q9. 公司在海外市场的布局是怎样的？ A9: 公司秉持立足中国、面向全球的发展战略。除深耕国内市场外，公司坚持贯彻全球化战略布局，在北美、拉美、印度、欧洲、中国台湾地区等地发展并打造了本地化服务和市场营销团队，在墨西哥、中国台湾、巴西和印度建立了本地化生产交付体系。同时，公司已建立起全球经销商网络并与诸多主流销售渠道建立合作关系，目前已开拓全球客户200余家，覆盖全球39个国家和地区，在美国、巴西等17个国家和地区均建有经销商网络。未来，公司将借助全球化运营/交付服务网络，进一步开拓国际一流客户和各地区性市场，加强品牌形象建设，提升全球市场占有率。</p> <p>Q10. 公司2023年度分红情况是怎样的？ A10: 为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实“提质增效重回报”，公司于2024年2月6日通过集中竞价交易方式回购约2,000万元公司股份。同时，未来将在公司经营情况和分红政策允许的前提下，积极推动股份回购和分红，以实际行动回馈股东，提升股东回报。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月30日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。